

2022年9月26日

各 位

会 社 名 東京応化工業株式会社
代 表 者 名 取締役社長 種市 順昭
コード番号 4186 (東証プライム)
問 合 せ 先 広報CSR部長 高須 亮一
TEL. 044-435-3000

会社分割及び株式譲渡による装置事業（一部を除く）の譲渡に関するお知らせ

東京応化工業株式会社（本社：川崎市中原区 / 社長 種市順昭、以下「当社」といいます。）は本日開催の取締役会において、当社の装置事業（一部を除く）（以下「対象事業」といいます。）を、当社が新たに完全子会社として設立する承継準備会社（以下「本件新会社」といいます。）に吸収分割（以下「本件会社分割」といいます。）により承継させた上で、本件新会社の株式の全てを AI メカテック株式会社（以下「AI メカテック」といいます。）に譲渡すること（以下「本件株式譲渡」といい、本件会社分割と合わせて「本件取引」といいます。）を内容とする契約（以下「本件株式譲渡契約」といいます。）を締結することを決議しましたので、お知らせいたします。本件株式譲渡契約に基づき、本件株式譲渡は 2023 年 3 月 1 日付で実施する予定です。

なお、本件会社分割は、当社の完全子会社に当社の事業を承継させる簡易吸収分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。また、当社は本日開催の取締役会において、当社の材料事業と AI メカテックに譲渡後の対象事業の協業（以下「本件協業」といいます。）を行うこと、及び、AI メカテック株式 1,101,500 株（総株主の議決権の数に対する割合：19.56%）（注）を取得することについても決議しており、係る決議の詳細については、それぞれ 2022 年 9 月 26 日付の当社プレスリリース「東京応化工業株式会社と AI メカテック株式会社との協業に関するお知らせ」及び「AI メカテック株式会社（証券コード 6227）の株式の取得（公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為）（予定）に関するお知らせ」をご参照ください。加えて、当社と AI メカテックは、2022 年 9 月 30 日以後、最初に開催される AI メカテックの定時株主総会において、当社が指名する取締役候補者 1 名を取締役として選任する議案を AI メカテックが当該定時株主総会に付議することを内容とする合意書を締結予定です。

（注）総株主の議決権の数に対する割合は、AI メカテックの 2021 年 6 月 30 日現在の総株主の議決権の数（56,300 個）を分母として計算（小数点以下第三位を四捨五入）しております。以下同様です。

記

1. 本件取引の目的

当社は、1940年の設立以来、研究開発型企業として最先端技術を追求し、高純度化学薬品から感光性材料のフォトレジストの高機能化へと技術を拡大し、ファインケミカルの分野で事業を展開してまいりました。

この間、当社のコアコンピタンスである微細加工技術と高純度化技術を徹底的に磨き、競争環境の厳しい電子材料の業界において、当社は独自のM&E (Materials and Equipment) 戦略によって、半導体用フォトレジスト、関連する高純度化学薬品等の高機能材料だけではなく、これらに関連する塗布装置、現像装置、灰化剥離装置等の製造装置を自社開発してきたことで競争力を維持・向上しており、係るM&E戦略の推進は今後も当社の競争力維持・向上に資するものであると考えております。

特に最近では、半導体業界の活況に伴い高機能材料が過去最高の売上高、営業利益をあげるとともに、装置事業においても、半導体用シリコン貫通電極形成プロセス等に使用されるウエハハンドリングシステム「ゼロニュートン[®]」が3次元実装市場の発展に伴い受注を伸ばしております。また、パワー半導体需要の拡大により、フォトレジスト灰化剥離装置であるプラズマアッシング装置の受注も増加基調で推移しております。

一方で、昨今の半導体製造装置業界においては、競争激化等を背景として技術革新のスピードが加速するなか、高度な専門性が求められ、ビジネスリソースや事業運営の合理化及び効率化が必要となっており、当社グループといたしましては、2030年のありたい姿である「豊かな未来、社会の期待に化学で応える “The e-Material Global Company[®]”」(注) という経営ビジョンの下、収益力・キャッシュ創出力の強化を達成し企業価値の向上を図るため、事業の選択と集中を模索してまいりました。

係る状況下、当社は、経営資源を中核の材料事業に集中するため、本件取引を通じて対象事業を、微細塗布技術や高精度貼り合わせ技術をコア技術として、液晶パネル製造装置等の開発、設計、製造、販売、アフターサービスを国内外で展開し、高度な技術力と顧客サポート力を備えた装置メーカーであるAIメカテックに譲渡するとともに、当社の材料事業とAIメカテックに譲渡後の対象事業の協業を企図した本件協業を行うことで、対象事業の強化及び持続的成長、並びに、当社のM&E戦略の維持及び更なる発展が期待されると考えたことから、本件取引を行うことを決定いたしました。

(注) 「e-Material」とは「Electronic material (電子材料)」のことをいいます。

2. 本件取引の日程

本件株式譲渡契約承認取締役会決議日	2022年9月26日(本日)
本件株式譲渡契約締結日	2022年9月26日(本日)(予定)
本件新会社設立日	未定
本件会社分割契約承認取締役会決議日	未定
本件会社分割契約締結日	未定
本件会社分割実行予定日(効力発生日)	2023年3月1日(予定)
本件株式譲渡実行予定日	2023年3月1日(予定)

(注) 本件会社分割は、当社においては会社法第784条第2項に定める簡易吸収分割に該当するため、当社の株主総会の承認を得ずに行います。

3. 本件会社分割の要旨

(1) 会社分割の方式

当社を分割会社、本件新会社を承継会社とする吸収分割です。

(2) 会社分割に係る割当ての内容

本件会社分割は、当社が当社の完全子会社との間で行うものであるため、本件新会社から株式の割当て、金銭その他の財産の交付は行われません。

(3) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社の新株予約権の取扱いについて、本件会社分割による変更はありません。

(4) 会社分割により増減する資本金

本件会社分割による当社の資本金の増減はありません。

(5) 承継会社が承継する権利義務

本件新会社は、対象事業に関する資産、負債及び契約上の地位等の権利義務のうち、吸収分割契約において定めるものを承継します。

(6) 債務履行の見込み

本件会社分割において、本件新会社が負担すべき債務の履行の見込みに問題はないと判断しております。

4. 本件会社分割の当事会社の概要（2022年6月30日時点。承継会社については設立時点（予定））

	分割会社	承継会社 (本件新会社)
名称	東京応化工業株式会社	未定
所在地	川崎市中原区中丸子 150 番地	未定
代表者の役職・氏名	取締役社長 種市 順昭	未定
事業内容	半導体・ディスプレイ等のフォトリソグラフィプロセスで用いられる感光性樹脂（フォトレジスト）・高純度化学薬品を中心とした製造材料、半導体用・ディスプレイ用製造装置などの各種プロセス機器、その他無機・有機化学薬品等の製造・販売	半導体用・ディスプレイ用製造装置などの各種プロセス機器の製造・販売
資本金	14,640 百万円	未定
設立年月日	1940 年 10 月 25 日	未定
発行済株式数	42,600,000 株	未定

決算期	12月31日		未定	
大株主及び持株比率 (注1)	日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	11.91%	東京応化工業株式会社	100.0%
	株式会社日本カस्टディ銀行(信託口)	6.56%		
	明治安田生命保険相互会社(常任代理人株式会社日本カस्टディ銀行)	4.52%		
	NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)	3.58%		
	株式会社三菱 UFJ 銀行	2.99%		
当 事 会 社 間 の 関 係	資本関係	本件会社分割の効力発生日に当社が本件新会社の発行済株式の100%を保有いたしますが、同日付で当社が保有する本件新会社の発行済株式の全てをAIメカテックに譲渡する予定です。		
	人的関係	未定		
	取引関係	未定		
最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態(注2)				
決算期	東京応化工業株式会社			
	2019年12月期	2020年12月期	2021年12月期	
売上高	102,820百万円	117,585百万円	140,055百万円	
営業利益	9,546百万円	15,589百万円	20,707百万円	
経常利益	9,707百万円	16,129百万円	21,664百万円	
親会社株主に帰属する 当期純利益	5,410百万円	9,926百万円	17,748百万円	
純資産	151,733百万円	159,994百万円	165,190百万円	
総資産	186,486百万円	201,185百万円	217,264百万円	
1株当たり当期純利益	130.02円	239.42円	430.73円	
1株当たり純資産	3,491.23円	3,651.20円	3,880.18円	

(注1) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(注2) 本件新会社は今後設立予定であるため、開示すべき財政状態及び経営成績はありません。

5. 分割する事業部門の概要

(1) 分割する事業内容

半導体・ディスプレイ製造用装置の製造・販売および保守

(2) 分割する部門の経営成績 (2021年12月期)

	対象事業 (a)	全事業計 (b)	比率 (a/b)
売上高	1,271百万円	140,055百万円	0.91%

(3) 分割する資産・負債の項目及び金額 (2021年12月期)

資産		負債	
項目	帳簿価格	項目	帳簿価格
流動資産	1,965百万円	流動負債	529百万円
固定資産	70百万円	固定負債	0百万円
資産合計	2,036百万円	負債合計	529百万円

(注) 分割する資産・負債の金額は、2021年12月31日現在の貸借対照表を基礎に作成しております。実際に分割する資産及び負債の金額は、上記金額に本件会社分割の効力発生日までの増減が調整されたうえで確定いたします。

6. 本件会社分割後の状況

本件会社分割後の当社及び本件新会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容（分割会社においては対象事業を除く。）、資本金及び決算期については、「4. 本件会社分割の当事会社の概要」に記載のとおりです。

7. 本件株式譲渡について

(1) 異動する子会社（新会社）の概要

「4. 本件会社分割の当事会社の概要」の承継会社（本件新会社）の項目に記載のとおりです。

(2) 株式譲渡の相手先の概要 (2022年6月30日時点)

名称	AIメカテック株式会社	
所在地	茨城県龍ケ崎市向陽台五丁目2番地	
代表者の役職・氏名	代表取締役 執行役員社長 阿部 猪佐雄	
事業内容	電子部品製造装置、周辺機器の設計・製造・販売及びアフターサービス	
資本金	450百万円	
設立年月日	2016年7月1日	
連結純資産	8,046百万円	
連結総資産	18,836百万円	
大株主及び持株比率 (注)	ポラリス第三号投資事業有限責	29.42%

		任組合	
		TIARA CG PRIVATE EQUITY FUND 2013, L.P.	9.70%
		BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	1.05%
		上田八木短資株式会社	0.94%
		野村證券株式会社	0.65%
当社と該会社との 関係	資本関係	本日時点で当社は同社と資本関係はございませんが、 当社は本日開催の取締役会において、同社の既存株主 から同社株式 1,101,500 株（総株主の議決権の数に対 する割合：19.56%）を取得することを定めた株式譲渡 契約書を締結することを決議しており、2022年9月30 日付で当該株式を取得する予定です。	
	人的関係	該当事項はありません。	
	取引関係	直前事業年度において、当社は同社と業務上の取引は ございませんが、当社は本日開催の取締役会において、 同社と協業に関する基本契約書を締結することを決議 しております。	
	関連当事者 への該当状 況	該当事項はありません。	

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

（3）譲渡前後の議決権所有割合、譲渡株式数及び譲渡価額の概要（予定）

譲渡前の所有株式数	未定（議決権所有割合 100%）
譲渡株式数	発行済株式の全て
譲渡後の所有株式数	0 株（議決権所有割合 0%）

※譲渡価額につきましては、株式譲渡契約における守秘義務条項により非開示としますが、両社で協議のうえ決定したものであります。

8. 今後の見通し

本件取引に関する今期の当社業績への影響につきましては軽微であると見込んでおりますが、現在精査中であり、公表すべき事項が発生した場合には、速やかに公表いたします。

以 上